



2018年1月15日

各 位

会社名 兼 松 株 式 会 社
代表者 代表取締役社長 谷川 薫
(コード番号 8020 東証1部)
問合せ先 財務部長 海野 太郎
(電話番号 03-5440-8000)

会社分割（簡易吸収分割）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2018年4月1日を効力発生日として、当社の電子・デバイス部門が営む事業のうち、電子部品・半導体事業及びシステム機器事業を会社分割し、新たに設立する兼松フューチャーテックソリューションズ株式会社に承継すること（以下「本会社分割」といいます。）を決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

なお、本会社分割は、新設する当社の100%子会社に当社の事業を承継させる簡易吸収分割であるため、開示事項及び内容を一部省略して開示しております。

記

1. 会社分割の目的

当社の電子・デバイス部門では、豊富な経験により培われたノウハウを活かし、開発段階から量産供給に至るまで、お取引先のニーズに合ったバリューチェーンを提案することにより、付加価値の高いビジネス構築を目指しております。

電子・デバイス部門で営む事業のうち、電子部品・半導体事業及びシステム機器事業においては、車載用・民生用を中心とした半導体・電子部品・カメラモジュール・ディスプレイ・EMS・IoT 関連サービスなど、多様な商品を取り扱っております。

これらの事業においては、業界の構造変化に伴い、より技術的な専門性を持った組織・人材・技術・インフラ等の体制構築が求められております。

今般、新設する承継会社に同事業を移管・一元化することにより、上記の商品やサービスを有機的に活用し、エレクトロニクス商社として最新の市場情報や技術とテクノロジーを用いて、企画・開発・設計段階よりお取引先へ提案を行い、最適なソリューションを提供すべく注力する所存です。また、意思決定の迅速化と経営効率の向上を図り、お取引先のニーズに機動的に対応して参ります。

2. 会社分割の要旨

(1) 会社分割の日程

取締役会決議日（当社）	2018年1月15日
契約締結日	2018年1月26日（予定）
株主総会決議日（承継会社）	2018年3月1日（予定）
効力発生日	2018年4月1日（予定）

(注) 本会社分割は、会社法第784条第3項に定める簡易吸収分割に該当するため、当社における吸収分割契約に関する株主総会の承認を得ることなく行います。

(2) 会社分割の方式

当社を分割会社とし、兼松フューチャーテックソリューションズ株式会社を承継会社とする吸収分割です。

(3) 会社分割に係る割当ての内容

承継会社は、本会社分割に際して普通株式 4,800 株を発行し、そのすべてを当社に対して割当て交付いたします。

(4) 会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

(5) 会社分割により増減する資本金

本会社分割による当社の資本金の増減はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

承継会社は、効力発生日において、分割会社である当社との間で締結する吸収分割契約に基づき、対象事業を遂行する上で必要と判断される資産、負債、契約上の地位その他の権利義務を承継いたします。なお、当社は承継会社が承継する債務を重畳的に引き受けます。

(7) 債務履行の見込み

本会社分割の効力発生日以降における当社及び承継会社が負担すべき債務については、履行の見込みに問題がないものと判断しております。

3. 会社分割の当事会社の概要

	分割会社 (2017年9月30日現在)	承継会社 (設立時予定)
(1) 名称	兼松株式会社	兼松フューチャーテック ソリューションズ株式会社
(2) 所在地	神戸市中央区伊藤町 119 番地	東京都港区芝浦 1 丁目 2-1
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 谷川 薫	代表取締役社長 山科 裕司
(4) 事業内容	電子・デバイス、食料、鉄鋼・ 素材・プラント、車両・航空等の 分野において商品・サービスを 提供する総合商社	半導体・電子部品・各種モジュ ール製品の輸出入・保管・売買・ 加工、EMS、IoT 関連製品の 企画・設計・販売等
(5) 資本金	27,781 百万円	10 百万円
(6) 設立年月日	1918 年 3 月 18 日	2018 年 1 月 18 日 (予定)
(7) 発行済株式数	422,501,010 株 *2017 年 10 月 1 日付け株式併合 (5 株を 1 株に併合) 後は、 84,500,202 株	100 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日

(9) 大株主及び持株比率	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 8.75% (信託口) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 5.10% (信託口) 三井住友海上火災保険株式会社 2.74% 東京海上日動火災保険株式会社 2.74% GOVERNMENT OF NORWAY 2.45%	兼松株式会社 100%
(10) 財政状態及び経営成績	2017年3月期(連結) [IRFS]	(注)
親会社の所有者に帰属する持分	100,357百万円	—
資産合計	479,717百万円	—
1株当たり親会社所有者帰属持分	238.44円	—
収益	675,579百万円	—
営業活動に係る利益	22,633百万円	—
税引前利益	17,875百万円	—
親会社の所有者に帰属する当期純利益	8,049百万円	—
1株当たり当期純利益(親会社の所有者に帰属)	19.13円	—

(注) 承継会社は、今後設立される予定の会社のため、確定した最終事業年度の財政状態及び経営成績はありません。

4. 分割する事業部門の概要

(1) 分割する部門の事業内容

半導体・電子部品・各種モジュール製品の輸出入・保管・売買・加工、EMS、IoT 関連製品の企画・設計・販売等

(2) 分割する部門の経営成績(2017年3月期)

売上高 24,479百万円

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額(2017年11月30日現在)

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	1,518百万円	流動負債	—百万円
固定資産	67百万円	固定負債	54百万円
合計	1,585百万円	合計	54百万円

(注) 分割する資産、負債の金額は、上記金額に本会社分割の効力発生日前日までの増減を加除した上で確定いたします。

5. 会社分割後の状況

	分割会社	承継会社
(1) 名称	兼松株式会社	兼松フューチャーテックソリューションズ株式会社
(2) 所在地	神戸市中央区伊藤町 119 番地	東京都中央区八丁堀 1 丁目 10 (2018 年 5 月頃、当該所在地に移転予定)
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 谷川 薫	代表取締役社長 山科 裕司
(4) 事業内容	電子・デバイス、食料、鉄鋼・素材・プラント、車両・航空等の分野において商品・サービスを提供する総合商社	半導体・電子部品・各種モジュール製品の輸出入・保管・売買・加工、EMS、IoT 関連製品の企画・設計・販売等
(5) 資本金	27,781 百万円	490 百万円
(6) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日

6. 今後の見通し

承継会社は当社の完全子会社となるため、本会社分割が連結業績に与える影響はありません。

(参考) 当期連結業績予想 (2017 年 5 月 10 日公表分) 及び前期連結実績 [IFRS]

(単位：百万円)

	収益	営業活動に係る利益	税引前利益	親会社の所有者に帰属する当期純利益
当期連結業績予想 (2018 年 3 月期)	700,000	25,000	23,500	12,000
前期連結実績 (2017 年 3 月期)	675,579	22,633	17,875	8,049

以 上